

PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4812D-C1-AUX_V1	焊接	QM0332025123001	V1	1/2	20251230

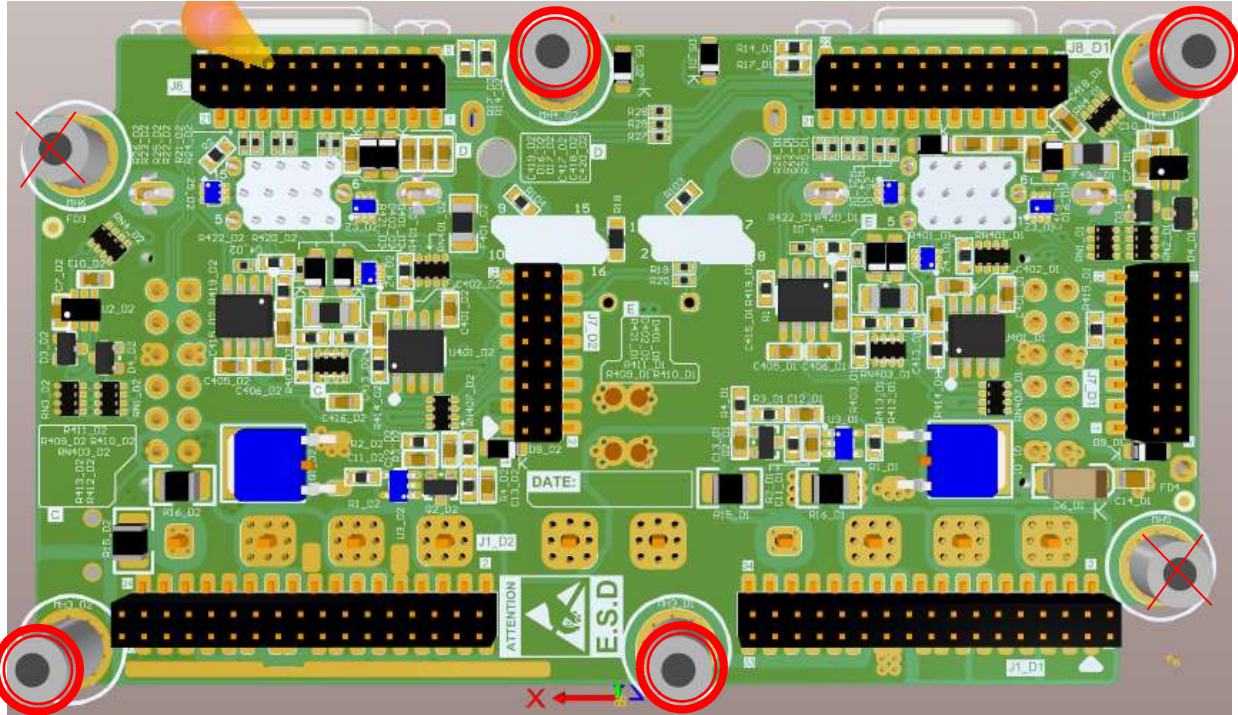
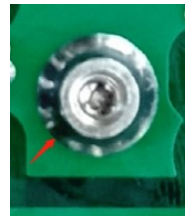
1) 底层贴片螺母焊接要求 (见右图) :

a) MH3_D1, MH3_D2 及 MH4_D1, MH4_D2 位置  焊接 SMTS03075CTJ (M3*7.5 带螺纹支撑柱)

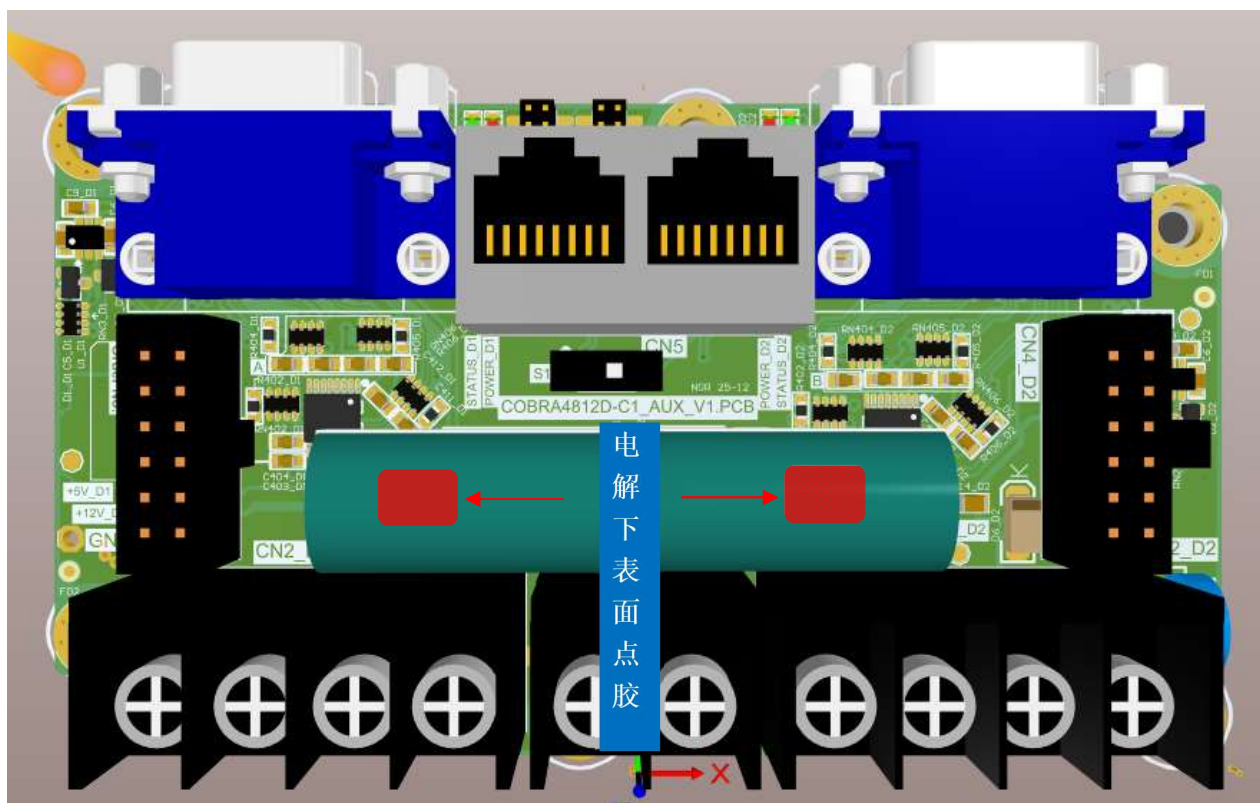
贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB;

b) 贴片螺母的焊盘圆周上的过孔注满锡, 焊锡与圆柱体形成锥面 (见右图);

c) 贴片螺母的顶端不能有沾锡




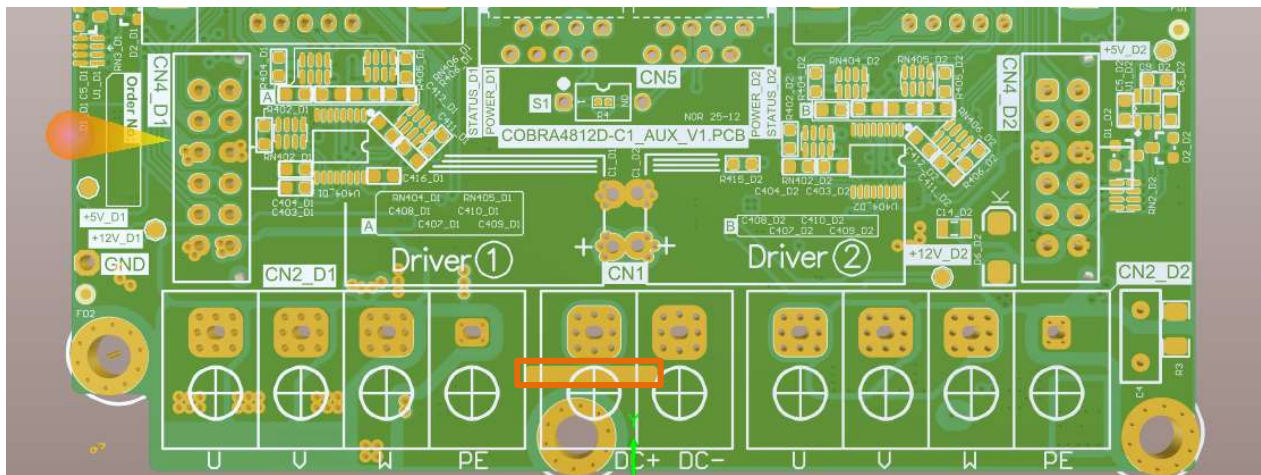
2) C1_AUX_V1 顶层电解电容管脚折弯 90 度焊接 (注意极性), 其与 PCB 接触面 (电解下面) 红色块区域为点胶位置分布图, 点固定胶 (黑色 704 固定胶), 点胶厚度为 1.5mm;





PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4812D-C1-AUX_V1	焊接	QM0332025123001	V1	2/2	20251230

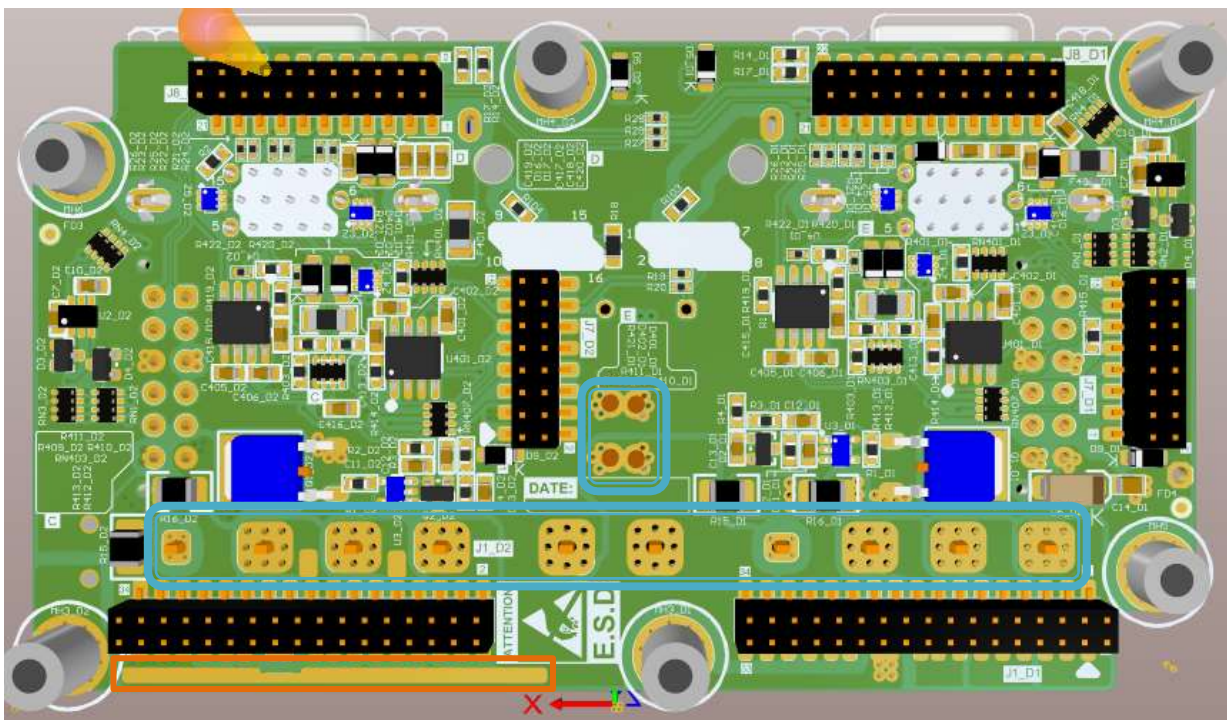
3) 加锡

顶层加锡焊接:  橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;



底层加锡焊接

-  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡;
-  橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;



其他焊接要求

- 1) 测试点, 不接受沾锡
- 2) 所有排针排母及端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 3) 所有极性元件, 严禁方向反(注: 其中二极管的负极都有字符“K”);
- 4) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 5) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 6) 手工操作要做防静电处理;
- 7) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	